

ATELIER 2016

15^{ème} Atelier

«ANALYSE ET MÉCANISMES DE DÉFAILLANCE
DES COMPOSANTS POUR L'ÉLECTRONIQUE »

Village Club Belambra « Les Tuquets »
Seignosse - Hossegor (Landes) - France

7 juin au 10 juin 2016

ORGANISE PAR

anadef

Association loi 1901

Analyse de défaillance & technologie
des composants électroniques

www.anadef.org

avec le concours de

 **Adera Congrès**
Orchestration d'excellence

MARDI 07 JUIN		MERCREDI 08 JUIN		JEUDI 09 JUIN		VENDREDI 10 JUIN	
8:30 – 9:30		8:30 – 10:00		8:30 – 10:00		8:30 – 10 :00	
Inscription		Tutoriel 2	Micro-atelier 3	Tutoriel 3	Session 3	Tutoriel 4	Session 5
9:30 – 10:00		Analyse de défaillance avancée : VLSI	PCB, assemblages et packaging : problématiques d'analyse	Analyse de défaillance des LEDs et des Diodes Laser	Analyse de défaillance des circuits intégrés	Composants passifs : technologies et analyse de défaillances	Analyse de défaillance des composants optoélectriques
Ouverture et présentation de l'atelier							
10:00 – 12:00		10:30 – 12:00		10:30 – 12 :00		10:30 – 12 :00	
Micro-atelier 1	Tutoriel 1	Tutoriel 2	Micro-atelier 3	Tutoriel 3	Session 3	Tutoriel 4	Micro-atelier 7
Mesures et caractérisations thermiques	Fondamentaux de l'analyse de défaillance	Analyse de défaillance avancée : VLSI	PCB, assemblages et packaging : problématiques d'analyse	Analyse de défaillance des LEDs et des Diodes Laser	Analyse de défaillance des circuits intégrés	Composants passifs : technologies et analyse de défaillances	Fiabilité dynamique
Déjeuner		Déjeuner		Déjeuner		12:30 – 13:00 : Bilan	
						Déjeuner	
14:00 – 15:30		14:00 – 15:30		14:00 – 15:30			
Session 1	Tutoriel 1	Session 2	Micro-atelier 4	Session 4	Micro-atelier 5	14:30 : Départ	
Assemblages et Packaging	Fondamentaux de l'analyse de défaillance	Analyse de défaillance des composants de puissance	Préparation d'échantillons	Défiabilisation des composants en utilisation	Localisation et caractérisation électrique de défauts dans les VLSIs	ATELIER 2016 15^{ème} Atelier 	
16:00 – 18:00		16:00 – 18:00		16:00 – 17:30			
Session 1	Micro-atelier 2	Session 2	Micro-atelier 4	Session 4	Micro-atelier 6		
Assemblages et packaging	Outils logiciels	Analyse de défaillance des composants de puissance	Préparation d'échantillons	Défiabilisation des composants en utilisation	Analyses de défaillances des MEMs et capteurs physiques ou chimiques		